

挠性覆铜板FCCL行业市场发展分析及发展趋势与投资前景研究报告(2026-2031版)

报告简介

挠性覆铜板是指在聚酯薄膜或聚酰亚胺薄膜等挠性绝缘材料的单面或双面，通过一定的工艺处理，与铜箔粘接在一起所形成的覆铜板。挠性覆铜板广泛用于航空航天设备、导航设备、飞机仪表、军事制导系统和手机、数码相机、数码摄像机、汽车卫星方向定位装置、液晶电视、笔记本电脑等电子产品中。由于电子技术的快速发展，使得挠性覆铜板的产量稳定增长，生产规模不断扩大，特别是高性能的以聚酰亚胺薄膜为基材的挠性覆铜板，其需求量和增长趋势更加突出。

我国挠性覆铜板(FCCL)从20世纪80年代开始研制，研制单位、企业有电子十五所、湖北化学研究院、原国营第704厂研究所等。1987年在原国营第704厂通过了“覆铜箔聚酰亚胺薄膜”和“覆铜箔聚酯薄膜”两种三层法挠性覆铜板的设计定型，并形成了1条自制的小型简陋生产线，为当时重要项目配套小批供货。由于市场开发和原材料方面限制等原因，我国挠性覆铜板在20世纪的80~90年代中期，除少数几个研究所有少量的生产，规模化生产基本上是空白。直到上世纪90年代中后期，才有中美合资的九江福莱克斯有限公司，形成了年产60万m²的生产能力。

进入21世纪，湖北化学研究院的挠性覆铜板逐渐形成较大产能，几家专业挠性覆铜板厂开始研发生产，台资几家挠性覆铜板公司如台虹科技、雅森电子、律胜科技等先后在大陆设厂，还有些刚性覆铜板厂家也增加了挠性覆铜板生产线。近几年，更有几家公司建成二十几条生产线。使我国挠性覆铜板的产量逐年增加，我国挠性覆铜板及相关制品的产量高速度增长。

在电子整机和半导体的驱动下，近几年，我国挠性覆铜板市场保持高速发展。我国挠性覆铜板的投建、投产项目，在2020年无论是规模，还是设备档次、品种水平等表现亮丽。多家内资FCCL企业投建、投产的高端挠性覆铜板项目以及投资方，都被国内外业界所加以关注，未来几年可能成为我国FCCL业的“黑马”。

本研究咨询报告由北京中道泰和信息咨询有限公司领衔撰写，在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家商务部、国家发改委、国务院发展研究中心、51行业报告网、全国及海外多种相关报刊杂志以及专业研究机构公布和提供的大量资料，对我国挠性覆铜板行业及各子行业的发展状况、上下游行业发展状况、市场供需形势、新产品与技术等进行了分析，并重点分析了我国挠性覆铜板行业发展状况和特点，以及中国挠性覆铜板行业将面临的挑战、企业的发展策略等。报告还对全球挠性覆铜板行业发展态势作了详细分析，并对挠性覆铜板行业进行了趋向研判，是挠性覆铜板生产、经营企业，科研、投资机构等单位准确了解目前挠性覆铜板行业发展动态，把握企业定位和发展方向不可多得的精品。

报告目录

第一章 挠性覆铜板的品种及主要性能要求

第一节 按不同基材分类的fccl品种

第二节 按不同构成分类的fccl品种

第三节 按不同应用领域分类的fccl品种

第四节 fccl品种的其它分类

第五节 产品主要采用的标准及性能要求

一、fccl管理体制

二、fccl相关标准

三、fccl的主要性能要求

第二章 挠性覆铜板的制造工艺法及其特点研究

第一节 三层型fccl的制造工艺法及其特点

一、片状制造法

二、卷状制造法

第二节 二层型fccl的制造工艺法及其特点

一、涂布法

二、溅射电镀法

三、层压法

四、三种工艺法生产的2l-fccl在性能、工艺特点方面的比较

第三节 近年fpc的技术发展方面

一、二层型fccl已成品种发展的主流

二、fccl近年在技术方面的进步

第三章 2021-2026年世界挠性覆铜板市场现状分析

第一节 2021-2026年世界挠性覆铜板产业发展概述

一、世界挠性覆铜板产业发展概述

二、世界fccl市场规模及结构

三、世界挠性覆铜板价格竞争分析

四、fccl原材料形态结构发生变化

第二节 2021-2026年世界挠性覆铜板区域市场分析

一、美国

二、日本

三、欧洲

四、韩国

五、中国台湾

第三节 2026-2031年世界挠性覆铜板产业发展前景预测分析

第四章 2021-2026年世界挠性覆铜板主要企业运营走势分析

第一节 新日铁化学株式会社

一、公司基本概况

二、公司经营与销售情况

三、2021-2026年公司竞争优势分析

第二节 宇部兴产株式会社

一、公司基本概况

二、公司经营与销售情况

三、2021-2026年公司竞争优势分析

第三节 台湾律胜科技股份有限公司

一、公司基本概况

二、公司经营与销售情况分析

三、公司竞争优势分析

第四节 新扬科技股份有限公司

一、公司基本概况

二、公司经营与销售分析

三、2021-2026年公司竞争优势分析

第五节 亚洲电材企业集团亚洲电材股份有限公司

一、公司基本概况

二、公司经营与销售情况分析

三、2021-2026年公司竞争优势分析

四、公司国际化战略发展

第六节 旗胜科技股份有限公司

一、公司基本概况

二、公司经营与销售情况分析

三、公司竞争优势分析

第七节 东丽世韩有限公司

一、公司发展基本概况

二、公司经营策略分析

第八节 sd电线有限公司

第五章 2021-2026年中国挠性覆铜板产业运营态势分析

第一节 2021-2026年中国覆铜板产业发展总体概述

一、中国覆铜板主要产品概述

二、中国覆铜板生产发展历程

三、中国覆铜板生产发展现状

四、中国覆铜板全面调研

五、中国覆铜板技改科研成果

第二节 2021-2026年中国挠性覆铜板产业发概况

一、中国挠性覆铜板产业发概况

二、中国挠性覆铜板生产情况分析

三、中国挠性覆铜板的产能与产量

四、中国挠性覆铜板企业销售状况

第三节 2021-2026年挠性覆铜板发展存在的问题与对策分析

第六章 2021-2026年中国挠性覆铜板相关市场调查

第一节 2021-2026年中国挠性印制电路业发展分析

一、柔性电路板相关概述

二、世界fpc产值及生产企业

三、我国fpc生产企业的现状

四、fpc多层挠性板的新技术

五、重庆彭水建柔性线路板基地

第二节 二层型挠性覆铜板在lcd的ic驱动用cof市场现状与发展

一、驱动ic用cof

二、驱动ic用cof挠性基板的性能特点及市场发展

三、cof挠性基板生产现状

第七章 2021-2026年中国印制电路板制造行业经济运行状况

第一节 2021-2026年中国印制电路板制造行业分析

第二节 2021-2026年中国印制电路板制造行业总体规模分析

一、2021-2026年中国印制电路板制造行业企业规模分析

二、2021-2026年中国印制电路板制造行业人员规模统计

三、2021-2026年中国印制电路板制造行业资产规模分析

四、2021-2026年中国印制电路板制造行业负债规模分析

五、2021-2026年中国印制电路板制造行业市场规模分析

第三节 2021-2026年中国印制电路板制造行业供需平衡分析

一、2021-2026年中国印制电路板制造行业产成品分析

二、2021-2026年中国印制电路板制造行业供给区域分布

三、2021-2026年中国印制电路板制造行业销售产值分析

四、2021-2026年中国印制电路板制造行业需求区域分布

第四节 2021-2026年中国印制电路板制造行业投资状况分析

- 一、2021-2026年中国印制电路板制造行业投资增长分析
- 二、2021-2026年中国印制电路板制造行业投资区域分布
- 三、2021-2026年不同规模印制电路板制造企业资产总额分析

第五节 2021-2026年中国印制电路板制造行业获利能力分析

- 一、2021-2026年中国印制电路板制造行业利润总额分析
- 二、2021-2026年不同规模印制电路板制造企业获利能力分析
- 三、2021-2026年中国主要省区印制电路板制造行业获利能力

第六节 2021-2026年中国印制电路板制造行业经营效益分析

- 一、2021-2026年印制电路板制造行业偿债能力分析
- 二、2021-2026年印制电路板制造行业盈利能力分析
- 三、2021-2026年印制电路板制造行业运营能力分析
- 四、2021-2026年印制电路板制造行业成长能力分析

第七节 2021-2026年中国印制电路板制造行业成本费用分析

- 一、2021-2026年印制电路板制造行业销售成本分析
- 二、2021-2026年印制电路板制造行业销售费用分析
- 三、2021-2026年印制电路板制造行业管理费用分析
- 四、2021-2026年印制电路板制造行业财务费用分析

第八节 2021-2026年中国印制电路板制造行业总体结构特征分析

- 一、2021-2026年印制电路板制造行业经济类型结构
- 二、2021-2026年印制电路板制造企业规模结构分析
- 三、2021-2026年印制电路板制造行业区域结构特征

第九节 2021-2026年中国印制电路板制造行业集中度分析

一、行业资产集中度分析

二、行业销售集中度分析

三、行业利润集中度分析

第八章 2021-2026年中国覆铜板及铜箔进出口数据监测分析

第一节 2021-2026年中国覆铜板及铜箔进口数据分析

一、2021-2026年中国覆铜板及铜箔进口数量情况

二、2021-2026年中国覆铜板及铜箔进口金额情况

第二节 2021-2026年中国覆铜板及铜箔出口数据分析

一、2021-2026年中国覆铜板及铜箔出口数量情况

二、2021-2026年中国覆铜板及铜箔出口金额情况

第三节 2021-2026年中国覆铜板及铜箔进出口均价分析

第四节 2021-2026年中国覆铜板及铜箔进出口国家及地区分析

一、2021-2026年中国覆铜板及铜箔进口国家及地区分析

二、2021-2026年中国覆铜板及铜箔出口国家及地区分析

第五节 2021-2026年中国覆铜板及铜箔进出口省市分析

一、2021-2026年中国覆铜板及铜箔进口省市情况

二、2021-2026年中国覆铜板及铜箔出口省市情况

第九章 2021-2026年中国覆铜板重点企业竞争力与关键性财务分析

第一节 广东生益科技股份有限公司

一、公司基本情况

二、企业经营情况分析

三、企业产品概述

四、企业发展优势

五、企业发展战略

第二节 金宝电子(中国)有限公司

一、公司基本情况

二、企业经营情况分析

三、企业产品概述

四、企业发展优势

五、企业发展战略

第三节 金安国纪科技股份有限公司

一、公司基本情况

二、企业经营情况分析

三、企业产品概述

四、企业发展优势

五、企业发展战略

第四节 广东超华科技股份有限公司

一、公司基本情况

二、企业经营情况分析

三、企业产品概述

四、企业发展优势

五、企业发展战略

第五节 山东金宝电子股份有限公司

一、公司基本情况

二、企业经营情况分析

三、企业产品概述

四、企业发展优势

五、企业发展战略

第六节 无锡宏仁电子材料科技有限公司

一、公司基本情况

二、企业经营情况分析

三、企业产品概述

四、企业发展优势

五、企业发展战略

第七节 广东汕头超声电子股份有限公司

一、公司基本情况

二、企业经营情况分析

三、企业产品概述

四、企业发展优势

五、企业发展战略

第八节 胜宏科技(惠州)有限公司

一、公司基本情况

二、企业经营情况分析

三、企业产品概述

四、企业发展优势

五、企业发展战略

第九节 诺德投资股份有限公司

一、公司基本情况

二、企业经营情况分析

三、企业产品概述

四、企业发展优势

五、企业发展战略

第十节 广东嘉元科技股份有限公司

一、公司基本情况

二、企业经营情况分析

三、企业产品概述

四、企业发展优势

五、企业发展战略

第十章 2021-2026年中国印刷电路板市场运行分析

第一节 2021-2026年中国印刷电路板行业发展概况

一、印刷电路板(pcb)分类及产业链

二、中国印刷电路板产量居世界首位

三、国内印刷线路板企业区域分布情况

四、印刷电路板技术发展水平及趋势

五、台湾柔性pcb公司在华东形成产业集群

六、重庆打造高技术印刷电路板产业高地

第二节 2021-2026年中国印刷电路板市场发展分析

一、2021-2026年中国印刷电路板产值规模

二、2021-2026年中国印刷电路板产品结构

三、中国印刷线路板市场集中度分析

四、中国印刷电路板市场需求特点分析

第三节 2021-2026年我国印刷电路板行业发展存在的主要问题分析

一、国内pcb配套产业还需进一步完善

二、产品集中于中低端成本转嫁能力弱

三、企业基础技术与开发水平薄弱

四、行业无序竞争产品定价能力有限

五、pcb企业环保投入需进一步加强

第四节 2021-2026年中国印刷电路行业发展对策分析

第十一章 中国挠性覆铜板用主要原材料业运行动态分析

第一节 挠性覆铜板用绝缘基膜--pi薄膜

一、绝缘基膜的生产方式

二、fccl发展对绝缘基膜性能提出了更高的要求

三、世界fccl用pi薄膜在品种和性能上的发展

四、世界挠性覆铜板用pi薄膜的市场需求情况

第二节 挠性覆铜板用导电材料

一、各类铜箔的品种及特征

二、压延铜箔

三、电解铜箔

四、fccl发展对铜箔性能提出更高的要求

第三节 挠性覆铜板用胶粘剂

- 一、fpc用胶粘剂发展概述
- 二、丙烯酸酯粘合剂研究与应用的状况
- 三、环氧树脂粘合剂研究与应用的状况
- 四、聚酰亚胺粘合剂研究与应用的状况
- 五、世界fpc及fccl用胶粘剂的主要生产厂家及品种

第四节 挠性覆铜板用覆盖膜

第十二章 中国挠性覆铜板用主要应用领域分析

第一节 航空航天

- 一、航空航天现状
- 二、挠性覆铜板在航空航天应用分析
- 三、挠性覆铜板在航空航天应用趋势

第二节 电脑

- 一、电脑现状
- 二、挠性覆铜板在电脑应用分析
- 三、挠性覆铜板在电脑应用趋势

第三节 汽车

- 一、汽车现状
- 二、挠性覆铜板在汽车应用分析
- 三、挠性覆铜板在汽车应用趋势

第四节 其他

第十三章 2026-2031年中国挠性覆铜板行业发展前景预测分析

第一节 2026-2031年中国挠性覆铜板行业发展趋势分析

一、印刷电路板行业预测分析

二、对未来fpc技术发展预测

三、fpc发展对fccl提出更高性能的要求

第二节 2026-2031年中国挠性覆铜板行业市场预测分析

一、覆铜板生产供给预测分析

二、挠性覆铜板供给预测分析

三、挠性覆铜板市场调查

第三节 2026-2031年中国挠性覆铜板行业盈利能力预测

第十四章 2026-2031年中国挠性覆铜板行业投资机会与风险分析

第一节 2026-2031年中国挠性覆铜板行业投资环境分析

第二节 2026-2031年挠性覆铜板行业投资机会分析

一、中国覆铜板行业投资情况分析

二、挠性覆铜板区域投资机会分析

三、挠性覆铜板行业投资吸引力分析

第三节 2026-2031年中国挠性覆铜板行业投资风险分析

一、宏观经济风险

二、市场竞争风险

三、原材料市场风险

四、技术研发风险分析

第四节 2026-2031年中国挠性覆铜板行业投资策略分析

附录

第一节 国民经济和社会发展第十四个五年规划

第二节 新能源汽车产业发展规划(—2035年)

图表目录

图表：挠性聚酰亚胺覆铜板产品性能要求

图表：挠性聚酯覆铜板产品性能要求

图表：二层挠性覆铜板三种生产工艺对比情况

图表：2021-2026年全球挠性覆铜板销售及销售额情况

图表：2021-2026年新日铁化学株式会社公司经营

图表：2021-2026年宇部兴产株式会社公司经营

图表：2021-2026年台湾律胜科技股份有限公司经营

图表：2021-2026年新扬科技股份有限公司经营

图表：2021-2026年台湾亚洲电材集团企业经营

图表：台湾亚洲电材集团企业

图表：2021-2026年旗胜科技股份有限公司经营

图表：按损耗因子分类的pcb材料

图表：中国覆铜板技改科研成果情况

图表：2021-2026年我国挠性覆铜板产量情况

图表：2021-2026年我国挠性覆铜板行业销售额情况

图表：2021-2026年中国印刷电路板企业数量情况

图表：2021-2026年中国印刷电路板行业从业人员数量情况

图表：2021-2026年中国印刷电路板行业资产规模分析

图表：2021-2026年中国印刷电路板行业负债规模情况

图表：2021-2026年中国印刷电路板行业市场规模情况

图表：中国印制电路板制造行业产成品

图表：2021-2026年中国印刷电路板行业销售收入分析

图表：国内印刷电路板需求区域分布情况

图表：pcb项目投资地分布情况

图表：2021-2026年中国印刷电路板行业利润总额

图表：2021-2026年广东生益科技股份有限公司营业收入

图表：2021-2026年金安国纪科技股份有限公司营收分析

图表：2021-2026年广东超华科技股份有限公司营收情况

图表：山东金宝电子股份有限公司部分产品示意图

图表：山东金宝电子股份有限公司部分产品示意图

图表：无锡宏仁电子材料科技有限公司研究人员

图表：2021-2026年广东汕头超声电子股份有限公司成长能力

图表：2021-2026年胜宏科技(惠州)有限公司营收情况

图表：2021-2026年诺德投资股份有限公司营收情况

图表：2021-2026年我国印刷电路板行业产值规模

图表：2021-2026年挠性覆铜板在航空航天应用

图表：2021-2026年我国挠性覆铜板在电脑应用规模

图表：2021-2026年挠性覆铜板在汽车应用市场规模

图表：2026-2031年中国覆铜板产量预测

图表：2026-2031年我国挠性覆铜板产量预测

把握投资 决策经营！

咨询订购 请拨打 400-886-7071 (免长途费) Email : kf@51baogao.cn

报告编号：222296

本文地址：<https://www.51baogao.cn/baogao/20210819/222296.shtml>

在线订购：[点击这里](#)